

RH-TCG-034 高导热凝胶树脂

特色:

- 单双组分（热）固化硅凝胶树脂
- 低粘度，填料填充度高
- 固化硬度低，耐热循环，耐老化
- 有效降低高填充体系粘度
- 低模量、低出油率

产品组成

- 硅凝胶

产品应用

- 用于配置导热填缝胶、导热垫等

常见性能参数*

产品名称	测试标准	RH-TCG-034	
		A 组分	B 组分
粘度	GB/T 10247	2700mpa. s	3300mpa. s
乙烯基含量	QZRH0040-2021	0.18%	0.14%
SiH 含量	QZRH0040-2021	0	0.01%
折射率	GB/T 614	1.40	1.40
密度	GB/T 4472	0.95 g/cm ³	0.92 g/cm ³
固化时间 (80 °C)	QZRH0040-2021	15 分钟	
操作时间 (室温)	QZRH0040-2021	40 分钟	
锥入度	1/4 锥	6 毫米	

*仅用作参考，每批次产品请参照质量质保书

应用方法

- 单独或与其他硅油/硅树脂作为导热凝胶的树脂使用，如需推荐使用工艺请咨询技术服务工程师

运输储存条件

双组分包装:

- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存
- 最佳使用期限为 12 个月以内

其他注意事项

- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 配方配置时, 需注意避免高温 (80 摄氏度以上)
- 如需返工, 再次使用前需清洁表面
- 注入胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触